



Research and
Development Center

业绩牛，半导体中报行情将至

电子行业周报

2021年7月6日

证券研究报告

行业研究

行业周报

电子

投资评级 看好

上次评级 看好



数据来源：万得，信达证券研发中心

方竞 电子行业首席分析师

执业编号：S1500520030001

邮箱：fangjing@cindasc.com

李少青 电子行业分析师

执业编号：S1500520080004

邮箱：lishaoqing@cindasc.com

刘志来 研究助理

邮箱：liuzhilai@cindasc.com

童秋涛 研究助理

邮箱：tongqiutao@cindasc.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编：100031

业绩牛，半导体中报行情将至

2021年7月6日

本期内容提要：

➤ **上半年板块涨幅回顾，半导体引领A股：**我们统计了2021年上半年的A股各板块涨跌幅。电子涨幅为11.82%。在SW一级行业中位列第七，弱于电气设备、钢铁、化工等板块。然而正如我们前期着力强调的，当下电子板块已有明显分化。**更具成长逻辑及业绩弹性的半导体板块已成为电子行业的主力军。**就涨幅来看，半导体板块上半年涨幅高达36.28%。如将半导体板块单独列示，并与其他A股板块进行对比，可见半导体板块涨幅位居A股各板块首位，引领A股。

➤ **中报季将来临，关注业绩超预期个股：**时至7月，中报季渐行渐近。不少优质公司亦发布了业绩预告。我们下文中将基于板块予以梳理。

芯片设计公司中，明微电子Q2净利2.04-2.34亿，同比实现了十余倍的净利增长，环比亦有200%以上提升。富满电子Q2净利2.38-2.68亿，同样有傲人的业绩表现。我们前期于4月12日发布的报告《关注LED驱动芯片投资机遇》中，着重强调了LED驱动芯片公司价量齐升的投资逻辑。预计同属这一赛道的晶丰明源亦将畅享业绩弹性。

此外，乐鑫科技Q2净利在0.66-0.86亿之间，公司作为智能家居的核心芯片供应商，在产能方面得到晶圆厂的鼎力支持，价格于3月末调涨，公司ESP32-C系列及S系列新品快速放量。长期成长空间可观。

韦尔股份Q2净利在12.01-14.03亿之间，通过有力业绩击碎了市场质疑。预计公司全年产能仍将保持30%以上增长；同时随着下半年新机发布和出货旺季来临，公司订单充足，全年高增长可期。

半导体设备公司中，北方华创Q2净利在2.03-2.58亿之间，中位数增长46.46%。公司于4月末发布定增预案，拟募集资金85亿元，其中34.8亿用于半导体设备产业化基地扩产，24.1亿用于半导体设备的研发，7.3亿用于电子元器件扩产。产能扩张将有效释放公司的业绩潜力。

封测公司中，长电科技及通富微电亦展示了不俗的业绩弹性。长电科技Q2净利预计在8.94亿，同比284.45%，环比131.42%。通富微电Q2净利2.14-2.64亿，同比73.70%-114.30%，环比37.11%-69.16%。

投资评级：缺货涨价态势下，半导体中报季业绩表现值得期待。**综合来看，板块公司业绩弹性与下游客户集中度，议价能力等因素息息相关。**下游市场越分散，涨价驱动力越强。而部分优质公司由于切入大客户，涨价幅度有限，短跑弱于其他厂商，但有助长线竞争力。

建议关注：晶圆厂及IDM（中芯国际、华虹半导体、华润微、士兰微、中车时代电气、闻泰科技）；设备厂商（北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业、华峰测控、长川科技、新益昌）；设计公司方面，我们着重关注IoT及新能源车带来的全新机遇，主要标的有：**IoT赛道**（乐鑫科技、敏芯股份、芯海科技）；**汽车电子赛道**（北京君正、韦尔股份）。此外，晶丰明源及富瀚微等优质标的亦值得长期关注。

➤ **风险因素：**市场竞争加剧；疫情持续，影响需求；技术渗透不及预期；中美贸易纠纷风险，半导体景气度下行风险。

目录

附录一：上周市场回顾.....	6
附录二：上周科技新闻回顾.....	7
附录三：近期行业数据整理更新.....	12
附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒.....	14

表目录

表 1: 年初至今 A 股各板块涨跌幅.....	4
表 2: 电子版块公司 Q2 业绩预告情况.....	4
表 3: 重要指数和价格变化.....	6
表 4: 苹果 A 系列与 M 系列 AP.....	12

图目录

图 1: 电子行业子板块周涨跌幅 (%).....	6
图 2: 电子行业个股周涨跌幅前五后五 (%).....	6
图 3: 1Q20~1Q21 PC 系统市占变化 (单位: %).....	12
图 4: 2010~2025 全球 PC 和平板出货量及预测 (单位: 亿).....	12
图 5: 1Q21 全球移动 IoT 模组供应商市占率 (单位: %).....	12
图 6: 2020~2024 年 3DXpoint 市场规模预估 (单位: 亿美元).....	12
图 7: 美光近 5 季 DRAM、NAND 营收变化 (单位: 亿美元).....	12
图 8: 2Q21 全球服务器出货量 (按客户分类, 单位: 千台).....	12

表 1: 年初至今 A 股各板块涨跌幅

SW 一级板块	涨跌幅	半导体及其他板块	涨跌幅
电气设备	23.83	半导体	36.28
钢铁	23.62	电气设备	23.83
化工	21.46	钢铁	23.62
综合	17.76	化工	21.46
采掘	17.30	综合	17.76
有色金属	12.49	采掘	17.30
电子	11.82	有色金属	12.49
医药生物	9.33	医药生物	9.33
汽车	8.88	汽车	8.88
纺织服装	8.27	纺织服装	8.27
银行	6.32	银行	6.32
轻工制造	5.84	轻工制造	5.84
公用事业	5.25	公用事业	5.25
休闲服务	5.22	休闲服务	5.22
机械设备	3.60	机械设备	3.60
建筑装饰	2.78	建筑装饰	2.78
建筑材料	2.26	建筑材料	2.26
交通运输	1.90	交通运输	1.90
食品饮料	0.59	食品饮料	0.59
计算机	-0.23	计算机	-0.23
商业贸易	-4.11	商业贸易	-4.11
通信	-5.85	通信	-5.85
传媒	-7.40	传媒	-7.40
农林牧渔	-7.76	农林牧渔	-7.76
房地产	-9.01	房地产	-9.01
国防军工	-11.50	国防军工	-11.50
非银金融	-14.71	非银金融	-14.71
家用电器	-15.59	家用电器	-15.59

资料来源: Wind, 信达证券研发中心

表 2: 电子板块公司 Q2 业绩预告情况

		下限	上限	YoY 下限	YoY 上限	QoQ 下限	QoQ 上限
设计	明微电子	2.04	2.34	1206.91%	1398.68%	211.94%	257.71%
	乐鑫科技	0.66	0.86	160.38%	239.28%	94.12%	152.95%
	韦尔股份	12.01	14.03	120.34%	157.35%	15.37%	34.75%
设备	芯源微	0.24	0.33	73.89%	137.78%	276.61%	414.98%
	北方华创	2.03	2.58	28.95%	63.99%	178.72%	254.46%
功率	新洁能	0.95	1.00	206.66%	222.83%	26.23%	32.89%
	扬杰科技	1.62	2.05	82.57%	131.38%	4.11%	31.94%
封测	长电科技	8.94	8.94	284.45%	284.45%	131.42%	131.42%
	气派科技	0.42	0.51	64.23%	99.19%	108.96%	153.45%
	利扬芯片	0.22	0.27	6.04%	32.28%	48.39%	85.12%
	通富微电	2.14	2.64	73.70%	114.30%	37.11%	69.16%
材料	雅克科技	8.94	8.94	284.45%	284.45%	131.42%	131.42%
消费电子	大族激光	5.20	5.70	0.71%	10.40%	57.43%	72.57%
电子品牌	传音控股	9.16	9.16	24.33%	24.33%	14.30%	14.30%
元器件	四方光电	0.37	0.40	61.72%	74.80%	12.79%	21.91%
电子品牌	极米科技	0.99	0.99	83.99%	83.99%	11.17%	11.17%
元器件	顺络电子	1.96	2.45	33.02%	65.82%	2.82%	28.17%

LED	澳洋顺昌	1.60	1.90	159.60%	208.16%	0.46%	19.25%
PCB	胜宏科技	1.83	2.35	16.88%	50.24%	0.23%	28.84%
分立器件	深圳华强	1.68	2.81	-0.42%	66.28%	-25.62%	24.21%

资料来源: Wind, 信达证券研发中心

附录一：上周市场回顾

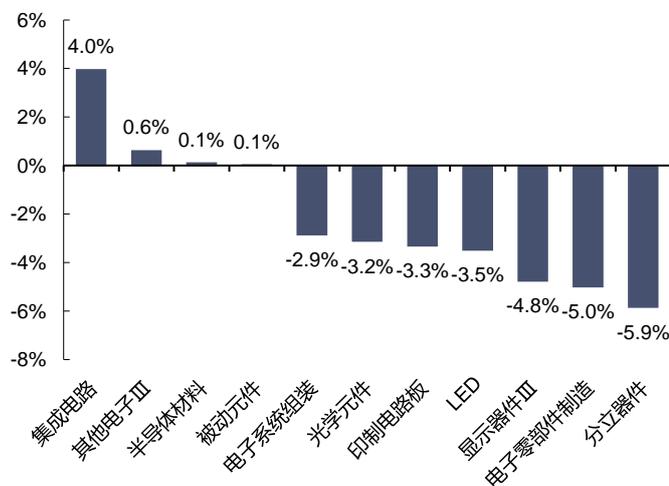
电子板块上周下跌 1.5%，跑赢沪深 300 指数 1.5 个百分点。年初至今电子板块上涨 7.8%，跑赢沪深 300 指数 10.3 个百分点。上周电子行业子板块涨幅分别为集成电路 3.98%，其他电子 III 0.64%，半导体材料 0.14%，被动元件 0.06%，电子系统组装-2.88%，光学元件-3.15%，印制电路板-3.34%，LED -3.51%，显示器件 III -4.79%，电子零部件制造-5.02%，分立器件-5.87%。就个股而言，上周涨幅位于前列的分别是明微电子 74.9%，富满电子 60.9%，利通电子 31.2%，康强电子 19.8%，诺德股份 18.2%。

表 3：重要指数和价格变化

全球股指	指数	周度涨跌幅	年初至今涨跌幅	原材料	价格	涨跌幅
沪深 300	5081.1	-3.0%	-2.5%	LME 铝	2557.5	2.9%
上证综指	3518.8	-2.5%	13.7%	LME 铜	9379.0	-0.4%
中小板指	9568.9	-2.5%	18.6%	DCE 塑料	8195.0	2.1%
创业板指	3333.9	-0.4%	13.6%	LME 镍	18330.0	-1.0%
道琼斯	34786.4	1.0%	10.3%	LME 锡	31520.0	2.4%
SOX	3315.8	2.3%	14.1%	LME 锌	2935.5	1.0%
纳斯达克	14639.3	1.9%	18.0%	人民币汇率		
A 股电子	5103.1	-1.5%	7.8%	美元	6.471	-0.05%
恒生科技	19937.3	-4.7%	-5.1%	欧元	7.663	-0.78%
台湾加权	17710.2	1.2%	20.2%	100 日元	5.799	-0.67%
台湾 IT	23494.4	-0.2%	13.4%	美元兑新台币	27.955	0.04%

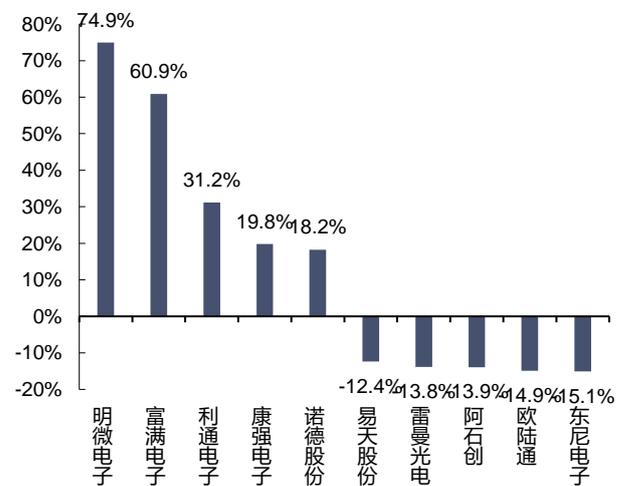
资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 1：电子行业子板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 2：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

附录二：上周科技新闻回顾

1、消费电子

出货量或首超海外

旭日大数据分析：2021年国产VCM马达市场占有率有望高达62%，首超海外。然而在成功实现“弯道超车”的背后，并不能盲目的乐观。机遇就在眼前，但挑战不容回避。中蓝电子营销中心副总经理党宏涛表示，下一轮的竞争态势，在于技术升级实力的比拼。（手机报）

非手机镜头厂福特科拟于科创板 IPO

近日，福特科光电在中国证监会IPO企业中赫然在列。根据招股说明书的内容显示，福特科光电是专业从事精密光学元器件、精密光学镜头的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供一站式光学解决方案。（手机报）

高通携手 43 家电信商与手机品牌共推 5G 毫米波技术发展

在MWC全球行动通讯大会中，众多行动通讯公司共同宣布携手支援全球5G毫米波技术，其中包括来自中国、欧洲、日本、韩国、北美和东南亚等越来越多地区的主要厂商。（中时新闻网）

Strategy Analytics: 2021 年底无线充电智能手机将突破 10 亿部

根据Strategy Analytics的最新研究，到2021年底，具有无线充电功能的智能手机数量将达到10亿部，其中，三星、小米和OPPO等智能手机厂商，英飞凌、联发科、三星SDI和高通等技术供应商有力地推广了这项功能。其年销售额连续十年保持两位数到三位数的增长，预计到2026年，全球将有超过22亿部支持无线充电的智能手机。（爱集微）

印度砸 10 亿美元推进生产关联激励计划，富士康、纬创获批参与

当地时间周四，印度电子信息技术部(MeitY)批准14家公司有资格参与针对笔记本电脑、平板电脑、一体机及服务器的生产关联激励(PLI)计划。这14家公司包含印度本土10家制造商，以及电脑品牌商戴尔、代工厂纬创、伟创力和富士康。（爱集微）

2、半导体

华虹半导体：连续 41 个季度盈利，“8+12”战略扩产加速

近日华虹半导体有限公司(01347.HK)与斯达半导体共同宣布，携手打造的高功率车规级12英寸IGBT芯片，已通过终端车企产品验证，广泛进入了动力单元等汽车应用市场。华虹半导体成为全球首家同时在8英寸和12英寸生产线量产先进型沟槽栅电场截止型IGBT的纯晶圆代工企业。（手机报）

美光科技 CEO：半导体在 5G 和电动汽车领域将有巨大增长

美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra表示，该公司在5G和电动汽车领域看到了半导体的巨大增长机会。现代化汽车和电动汽车需要更多的内存和存储空间，未来将成为车轮上的数据中心，这将增加对芯片的需求。（盖世汽车）

中国反垄断局无条件批准智路资本收购美格纳半导体股权案

国家市场监督管理总局反垄断局公开信息显示，智路资本收购美格纳半导体股权案已获无条件批准。根据披露的信息，该案审结时间为 2021 年 6 月 21 日。（爱集微）

韩国政府宣布将为芯片制造业扩大税收优惠并放松监管

韩国贸易工业和能源部周四表示，计划为国内芯片制造商提供更多的税收优惠，取消更多的监管，以期和韩国成为全球存储和系统半导体强国的愿景统一步调。这也是韩国公布的“K-半导体产业带”蓝图的后续措施，即扩大税收优惠并放松监管。据悉，这份拟议法案将于 9 月前提交议会。（爱集微）

欧盟无条件批准 AMD 收购赛灵思

当地时间 6 月 29 日，AMD 发布公告表示，350 亿美元收购赛灵思的计划获得欧盟监管机构无条件批准。英国竞争和市场管理局于 6 月 29 日批准了该笔交易。（爱集微）

ZVEI: 欧洲半导体全球市占率 2025 年将降至 8%

德国电子业同业公会(ZVEI)近日公布的微电子业趋势报告指出，全球半导体市场 2025 年前的年成长率达 6.5%，比过去 5 年增加 1 个百分点。不过，欧洲半导体的全球市占率将从目前的 9%，下滑到 2025 年的 8%。（爱集微）

IC Insights: 2023 年全球芯片市场收入将突破 6000 亿美元大关

市场研究机构 IC Insights 发布最新报告指出，受益于市场的强劲需求，今年整体芯片市场的收入预计将提高 24%，并突破史上首个 5000 亿美元大关。IC Insights 还指出，芯片市场增长态势预计将持续到 2023 年。在 5G、人工智能、深度学习、虚拟现实、以及移动设备、数据中心、云计算服务器、汽车和工业市场的其他新兴应用驱动下，预测期（2020-2025 年）内芯片市场的年复合增长率将达到 10.7%。到 2023 年，全球芯片市场收入将突破 6000 亿美元。（爱集微）

三星成功流片 3nm GAA 芯片

日前三星宣布，与 Synopsys 合作的采用 GAA 架构的 3nm 制程技术已经正式流片。这意味着该工艺距离大规模应用又近了一步，不过最终的进度依然不明确，三星最早表示在 2021 年就能量产，后来推迟到 2022 年，而明年台积电 3nm 工艺即将量产。（爱集微）

台媒：马来西亚封锁期延长或使 MOSFET 交期持续延长，报价上涨

马来西亚疫情严重，原定 6 月 28 日届满的全国封锁措施无限期延长。台媒《工商时报》报道指出，由于当地有英飞凌、安森美及意法半导体等 IDM 大厂，在人流降载情况下，将使 MOSFET 交期持续延长，且报价有望再度调升。（爱集微）

英国反垄断机构批准 SK 海力士收购英特尔 NAND 业务

据外媒报道，英国反垄断机构(CMA)日前表示，根据目前掌握的信息，决定不再对“SK 海力士收购英特尔 NAND 业务”进行第二阶段审查，这意味着英国已批准该项交易。（爱集微）

8 英寸硅晶圆下半年看涨 10%

因需求强劲但库存过低，8 英寸硅晶圆合约价在睽违近两年半后，终于要在第三季度调涨，下半年涨幅约达 5-10%。中国台湾《工商时报》文章指出，8 英寸晶圆代工产能自去年下半年以来就供不应求，但之前 8 英寸硅晶圆仍处于去库存阶段，直至今年第二季度才开始出现供应吃紧的状况，现货价也止跌回稳。（爱集微）

出价 9 亿美元！TI “接盘” 美光工厂

当地时间周三，德州仪器 (TI) 宣布已与美光科技签署一项收购协议，以 9 亿美元收购了后者位于犹太州的 Lehi 工厂，协议还包括继续雇佣原美光 Lehi 厂员工。此次收购 Lehi 厂后，TI 旗下 300mm 晶圆厂阵容将增至 4 座。（国际电子商情）

比亚迪半导体 IPO 进展“神速”，已获深交所受理

6 月 30 日比亚迪股份公布称，子公司比亚迪半导体提交在深圳交易所创业板首次公开发售及上市的申请材料，已接获相关通知。深交所依据相关规定，对申请报告及文件进行核对，认为文件齐备，决定予以受理。这意味着，比亚迪半导体分拆上市的计划，已进入最后阶段。（国际电子商情）

意法半导体宣布与 Tower 半导体联手建设意大利 300 毫米晶圆厂

意法半导体与 Tower Semiconductor 宣布达成协议，意法半导体将欢迎 Tower 加入其在意大利 Agrate Brianza 工厂建设中的 Agrate R3 300mm 晶圆厂。意法半导体和 Tower 将联手加快晶圆厂的投产速度。该晶圆厂预计将在今年晚些时候完成设施安装，并在 2022 年下半年开始生产。（SEMI 新闻）

深南电路拟 60 亿元投建广州封装基板生产基地项目

深南电路拟以自有资金及自筹资金 60 亿元用于广州封装基板生产基地项目建设。项目总投资约人民币 60 亿元，其中固定资产投资总额累计不低于 58 亿元，项目一期固定资产投资不低于 38 亿元，项目二期固定资产投资不低于 20 亿元。（SEMI 新闻）

扬杰科技集成电路及功率半导体封装测试项目顺利投产

6 月 28 日，扬杰科技集成电路及功率半导体封装测试项目顺利投产。本次项目占地 400 亩，总建筑面积约 28 万平方米，主要从事功率器件、集成电路封装测试的研发、生产和销售。（SEMI 新闻）

募资逾 35 亿元， 国产 CPU 厂商龙芯中科正式闯关科创板

6 月 28 日，龙芯中科技术股份有限公司科创板 IPO 上市申请正式获得受理。（全球半导体观察）

新增月产能 2 万片， 粤芯半导体二期项目预计明年 Q1 投产

广州粤芯半导体技术有限公司正式完成二期项目融资，主要将用于粤芯半导体二期项目建设。二期项目新增月产能 2 万片，技术节点将延伸至 55nm 工艺，目前设备正在陆续搬入，预计 2022 年第一季度投产。（全球半导体观察）

3、汽车电子

福特因缺芯暂停部分北美工厂生产

福特汽车 6 月 30 日表示，由于全球半导体短缺，其北美部分工厂将在 7 月和 8 月关闭数周。其中芝加哥装配厂将从 7 月 5 日当周关闭至 7 月 26 日当周；堪萨斯城装配厂的 F-150 皮卡生产线也将停产两周；密歇根州组装工厂将在 7 月停工两周。（盖世汽车）

英国经销商集团 Pendragon：芯片短缺导致订单延迟

英国第四大经销商集团 Pendragon 表示，由于全球半导体短缺，该公司正被迫推迟车辆交付，并警告称，2021 年下半年的芯片供应将继续紧张。（盖世汽车）

上汽集团董事长陈虹：行业缺芯问题或在 7 月下旬缓解

6 月 30 日消息，上汽集团董事长陈虹在回应股东关于“芯片短缺”问题时表示，芯片短缺是整个汽车行业面临的问题，预计到 7 月下旬会缓解，第三、第四季度基本上会恢复正常。（盖世汽车）

乘联会：芯片短缺对中国汽车出口利好明显

6 月 29 日，乘联会秘书长崔东树撰文表示，2021 年 1-5 月在海外疫情冲击下，中国汽车出口 76 万台，同比增长 103%，中国出口市场持续走强。尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，新能源出口欧洲 2.3 万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好。（盖世汽车）

德国 7 月将有 100 万辆电动汽车上路

德国经济部长 Peter Altmaier 称，7 月份德国将有 100 万辆电动汽车上路，该国的长期目标是使 700 万至 1000 万辆电动汽车上路。（盖世汽车）

聚焦功率半导体，雷诺与意法半导体达成战略合作

福布斯报道称，雷诺集团与意法半导体公司达成战略合作伙伴关系，以确保雷诺从 2026 年开始为旗下的纯电动和混合动力汽车提供足够的功率半导体。（爱集微）

新能源汽车，碳化硅器件加快替代硅基 IGBT

近日，特斯拉发布了一款新车型——Model S Plaid。该车的创新之一是搭载了由碳化硅(SiC)为主要器件的逆变器。随着越来越多新能源车型采用碳化硅器件，显示出碳化硅对传统车用硅基 IGBT 的替代已经逐渐展开，为碳化硅产业的发展展现出良好的前景（SEMI 新闻）

4、面板/LED/PCB 等

2021 年 OLED 电视面板出货量将达 830 万台，同比增长 86%

6 月 27 日，据韩联社报道称，Omdia 预计今年 OLED 电视面板的出货量为 830 万台，相较于去年的 450 万台，其出货量同比增长约 86%。目前，OLED 电视面板是由 LG Display 独家生产，其在年初提出了 2021 年出货量目标为

800 万台，Omdia 预计 LG Display 将能够实现这一目标。(爱集微)

品牌转攻大尺寸与中高阶电视推升今年 QLED、OLED 电视出货创新高

根据 TrendForce 调查显示，2021 年电视品牌面临面板价格不断上涨，以及整机用的相关半导体零组件涨价和缺料的压力，导致品牌不得不缩减中小尺寸出货规模，转战获利丰厚的大尺寸和中高阶产品，顺势推升今年中高阶 QLED 电视出货量达 1,102 万台，年增 22.4%；OLED 电视出货量则达 710 万台，年增 80%，两者皆创下新高。(台湾物联网产业技术协会)

华星光电：1080P 面板获小米采用，武汉模组厂房主体结构封顶

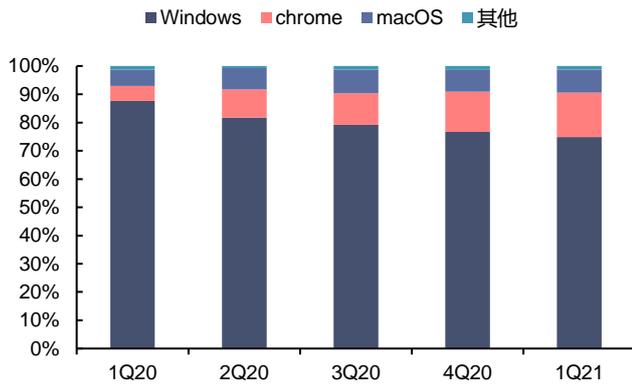
小米将为 MIX 4 引入屏下摄像头技术，成为小米旗下首款量产的屏下前摄手机，该机将采用华星光电的定制屏幕，以此来实现屏下前摄的配备。据中建集团官网报道，6 月 18 日，中建四局承建的武汉华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目模组厂房 2 项目主体结构封顶。(群智咨询)

延迟超 18 个月后 TCL 华星印度厂将于 Q4 启动生产

据印度媒体 ET Telecom 报道，在延迟超过 18 个月后，TCL 集团位于印度安得拉邦蒂鲁帕蒂的工厂将于第四季度开始生产手机和电视显示面板，并计划招聘约 1000 名员工。(群智咨询)

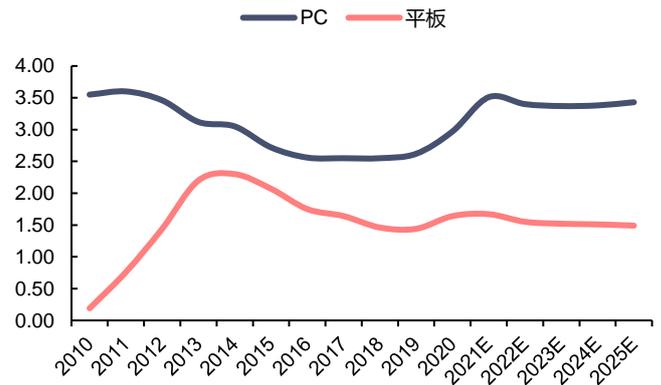
附录三：近期行业数据整理更新

图 3：1Q20~1Q21 PC 系统市占变化（单位：%）



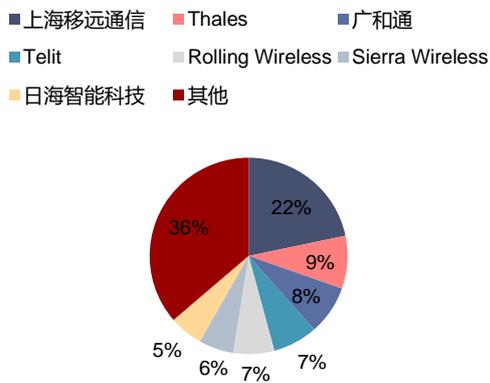
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 4：2010~2025 全球 PC 和平板出货量及预测（单位：亿）



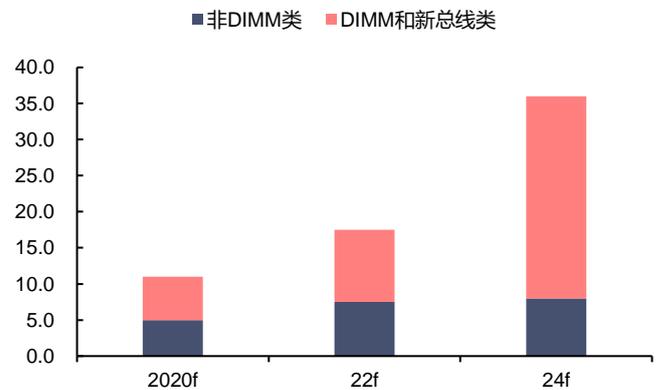
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 5：1Q21 全球移动 IoT 模组供应商市占率（单位：%）



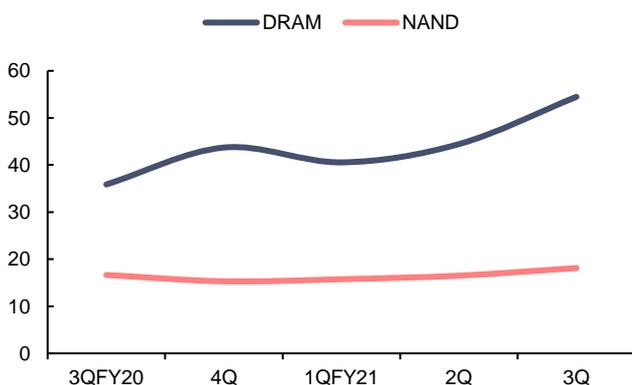
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 6：2020~2024 年 3DXpoint 市场规模预估（单位：亿美元）



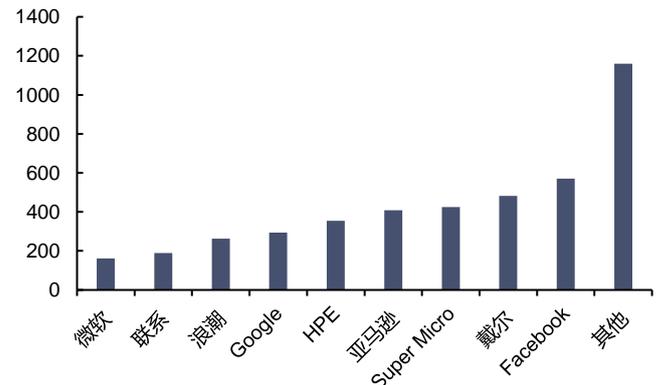
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 7：美光近 5 季 DRAM、NAND 营收变化（单位：亿美元）



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 8：2Q21 全球服务器出货量（按客户分类，单位：千台）



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

表 4：苹果 A 系列与 M 系列 AP

AP	CPU 指令集架构	制程	晶粒面积(mm ²)	推出时间
M1	ARMv8.4-A	台积电 5 奈米	119	2020/11/10

A14 Bionic	ARMv8.5-A	台积电 5 奈米	88	2020/10/23
A13 Bionic	ARMv8.4-A	台积电 7 奈米	98.48	2019/9/20
A12Z Bionic	ARMv8.3-A	台积电 7 奈米	135	2020/3/25
A12X Bionic	ARMv8.3-A	台积电 7 奈米	135	2018/11/7
A12 Bionic	ARMv8.3-A	台积电 7 奈米	83.27	2018/9/21
A11 Bionic	ARMv8.2-A	台积电 10 奈米	87.66	2017/9/22
A10X Fusion	ARMv8.1-A	台积电 10 奈米	96.4	2017/6/13
A10 Fusion	ARMv8.1-A	台积电 16 奈米	125	2016/9/16
A9X	ARMv8.0-A	台积电 16 奈米	143.9	2015/11/11
A9(APL 0898)	ARMv8.0-A	三星 14 奈米	96	2015/9/25
A9(APL 1022)	ARMv8.0-A	台积电 16 奈米	104.5	2015/9/25
A8X	ARMv8.0-A	台积电 20 奈米	128	2014/10/22
A8	ARMv8.0-A	台积电 20 奈米	89	2014/9/19
A7	ARMv8.0-A	三星 28 奈米 H κ MG	102	2013/9/20 2013/11/1
A6X	ARMv7s	三星 32 奈米 H κ MG	123	2012/11/2
A6	ARMv7s	三星 32 奈米 H κ MG	96.71	2012/9/21
A5X	ARMv7	三星 45 奈米	165	2012/3/16
A5(APL 7498)	ARMv7	三星 32 奈米 H κ MG	37.8	2013/1/28
A5(APL 2498)	ARMv7	三星 32 奈米 H κ MG	69.6	2012/3/7
A5(APL 0498)	ARMv7	三星 45 奈米	122.2	2011/3/11
A4	ARMv7	三星 45 奈米	53.3	2010/4/3

资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒

【新洁能】发布 2021 年半年度业绩预增公告，预计公司实现归母净利润 1.70-1.75 亿元，同比增长 207.20%-216.23%；扣非净利 1.66-1.71 亿元，同比增长 212.48%-221.90%。

【富满电子】公司发布 2021 年半年度业绩预告，预计 2021 年半年度归母净利润为 3-3.3 亿元，同比增长 1124.56%-1247.02%

【汇顶科技】截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2018 年、2019 年股票期权激励计划首次授予部分，分别累计行权且完成股份过户登记 1,602,559 股、442,862 股，均占可行权股票期权总量的 99.98%。

【立讯精密】2018、2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格分别由 10.28 元/股调整为 10.17 元/股、由 13.70 元/股调整为 13.59 元/股；2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 340 名调整为 332 名，股票期权数量由 65,977,698 份调整为 65,232,789 份；调整后在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 16,200,478 份，行权价格为 13.59 元/股；

2021 年第二季度可转换公司债券转股的转股价格为人民币 58.25 元/股（2021 年 7 月 8 日生效），转股期限为 2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日。

【安集科技】2020 年股票激励计划首次授予部分第一个归属期，归属股票数量共 11.22 万股，上市流通时间为 2021 年 7 月 7 日。

【中微公司】向特定对象发行 A 股股票上市，数量为 80,229,335 股，价格为 102.29 元/股，募集资金总额为人民币 8,206,658,677.15 元，募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元

【圣邦股份】截至本公告日，刘明女士、张绚女士分别通过集中竞价方式减持 7,500 股、80,850 股，合计占公司目前总股本的 0.0376%

【晶丰明源】公司股票将于 2021 年 7 月 5 日开市起复牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买 14 位股东持有的南京凌鸥创芯电子有限公司 95.75% 的股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。

【士兰微】中国证监会对士兰微发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核，公司本次重组事项获得有条件通过。公司 A 股股票自 2021 年 7 月 1 日（星期四）开市起复牌。

【圣邦股份】公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 84 人，可行权的股票期权数量合计为 282,694 份，行权价格为 108.66 元/股，第一个行权期行权期限为 2021 年 7 月 2 日起至 2022 年 6 月 6 日止。

【北方华创】2021 年上半年营收预计 32.65-39.19 亿元，同比增长 50% - 80%；归属于上市公司股东的净利润 2.76-3.31 亿元，同比增长 50% - 80%；基本每股收益 0.5603 元/股-0.6723 元/股

【韦尔股份】预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 12.5 亿元至 14.5 亿元，同比增加 126.41%到 146.78%。

【顺络电子】2021 年上半年预计归属于上市公司股东的净利润 3.87-4.36 亿元，同比增长 60-80%，基本每股收益 0.49 元/股-0.55 元/股。

【长电科技】2021 年 6 月 28 日，公司收到产业基金告知函，其于 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 25 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1779.55 万股，占公司总股本的 1.00%，本次减持计划减持数量已过半。

研究团队简介

方竞，西安电子科技大学本硕连读，近5年半导体行业从业经验，有德州仪器等外企工作经历，熟悉半导体及消费电子产业链。同时还是国内知名半导体创业孵化平台IC咖啡的发起人，曾协助多家半导体公司早期融资。2017年在太平洋证券，2018年在招商证券，2020年加入信达证券，任电子行业首席分析师。所在团队曾获19年新财富电子行业第3名；18/19年《水晶球》电子行业第2/3名；18/19年《金牛奖》电子行业第3/2名。

李少青，武汉大学硕士，2018年加入西南证券，2020年加入信达证券，主要覆盖晶圆厂、数字芯片及射频，同时兼顾面板及智能机。

刘志来，上海社会科学院金融硕士，2020年加入信达证券，覆盖VRAR，光学，存储器板块。

童秋涛，复旦大学资产评估硕士，2020年加入信达证券，产能为王，覆盖功率、模拟、封测板块。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiyue@cindasc.com
华北副总监 (主持工作)	陈明真	15601850398	chenmingzhen@cindasc.com
华北	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北	刘晨旭	13816799047	liuchenxu@cindasc.com
华北	欧亚菲	18618428080	ouyafei@cindasc.com
华北	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北	魏冲	18340820155	weichong@cindasc.com
华北区销售	陆禹舟	17687659919	luyuzhou@cindasc.com
华东副总监 (主持工作)	杨兴	13718803208	yangxing@cindasc.com
华东	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华东	张琼玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华南总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南	王之明	15999555916	wangzhiming@cindasc.com
华南	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com
华南	焦扬	13032111629	jiaoyang@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深300指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起6个月内。	买入 ：股价相对强于基准20%以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准5%~20%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5%之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准5%以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。